



PDC 1: 算力芯片的先进封装技术

于大全 教授 中国厦门大学, 厦门云天半导体科技有限公司

课程摘要:

1. AI 驱动算力芯片快速发展
2. 算力芯片的先进封装需求
 - 算力芯片的先进封装发展
 - 1) 硅通孔中介层封装技术
 - 2) 有机中介层封装技术
 - 3) 基于桥连封装技术
 - 4) 玻璃中介层与玻璃基板技术
 - 5) 光电合封技术
 - 6) 高性能散热技术
3. 算力芯片的先进封装发展趋势与挑战
4. 总结

课程大纲:

适应对象:

讲师简介:

2004 年就读于大连理工大学, 获工学博士学位。曾在香港城市大学、德国夫豪恩霍夫可靠性和微集成研究所、新加坡微电子所等国际知名研究机构开展研究工作; 2010—2015 年担任中国科学院微电子研究所研究员; 2014—2019 年担任天水华天科技股份有限公司封装技术研究院院长。2019 年担任云天半导体董事长、厦门大学特聘教授。担任国家科技重大专项 02 专项总体组特聘专家, 中国半导体行业协会 MEMS 分会副理事长, 全国半导体器件标准化技术委员会委员, IEEE 高级会员。先后入选中科院“百人计划”、厦门市和福建省“百人计划”等人才。主持多个国家科技重大专项 02 专项、课题, 发表学术论文 200 余篇, 授权国家发明专利 70 多项, 荣获 2020 年国家科技进步一等奖。